

中国封装基板行业现状深度研究与投资前景分析 报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国封装基板行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/695341.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1、封装基板概述

封装基板 (Package Substrate)是由电子线路载体(基板材料)与铜质电气互连结构 (如电子线路、导通孔等)组成，其中电气互连结构的品质直接影响集成电路信号传输的稳定性和可靠性，决定电子产品设计功能的正常发挥。封装基板属于特种印制电路板，是将较高精密度的芯片或者器件与较低精密度的印制电路板连接在一起的基本部件。封装基板按基板材质不同，可分为硬质封装基板、柔性封装基板和陶瓷封装基板，其中以硬质基板中的BT封装基板和ABF封装基板为主。

不同基板材质的封装基板对比

基板材质

基板材料

特点

应用领域

硬质基板

BT

高Tg、高耐热性、耐湿性、低介电常数Dk、低散失因素Df、高抗铜离子迁移、优异的机械性能。

手机MEMS芯片、LED芯片、存储芯片

ABF

导电性强，适合更薄、高脚数、高传输速率的封装基板。

CPU、GPU、FPGA等大型高端芯片

MIS

包含一层或多层预包封材料，通过电镀铜进行互联；相比QPN封装，布线更细、传输能力更好、外形更小。

模拟、功率IC等领域

柔性基板

PI、PE

可折叠，重量轻，薄型化、耐热性好，配线空间限制少适用于高密度布线。

消费电子、智能显示、高端装备产业等领域

陶瓷基板

氧化铝、氮化铝、碳化硅等

优良电绝缘性能，高导热特性，耐热性好，高强度。

汽车电子、航空航天、军用电子

资料来源：观研天下整理

在产业链方面，封装基板行业上游主要为结构材料和化学材料，如树脂、铜箔和绝缘材料等，下游为各种电子设备，汽车电子，航空航天行业等。

封装基板行业产业链图解

资料来源：观研天下整理

2、全球封装基板行业产值稳定增长，我国内资厂商产值占比低

封装基板产品有别于传统PCB，高加工难度与高投资门槛是封装基板的两大核心壁垒。从产品层数、板厚、线宽与线距、最小环宽等维度看，封装基板更倾向于精密化与微小化，而且单位尺寸小于150*150mm，是一类更高端的PCB，其中线宽/线距是产品的核心差异，封装基板的最小线宽/线距范围在10~130um，远远小于普通多层硬板PCB的50~1000um。

近年来，全球封装基板行业产值稳定增长，2022年约为174亿美元，预计2027年产值将达到223亿美元，2022-2027年CAGR约5.10%。市场格局方面，2022年，我国台湾、韩国与日本的封装基板厂商产值占整体产值超90%。其中，中国台湾封装基板厂商占比最高，达到38.3%，而中国大陆内资封装基板厂商仅占整体产值的3.2%，占比较低。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3、投资规模大叠加产能爬坡周期长铸就高行业壁垒，我国封装基板国产化率较低

由于我国封装基板产业起步时间较晚，并且受关键原料与高端设备等因素影响，内资厂商在技术水平、工艺能力及产业链布局等方面与外资厂商相比差距较大，进而使得国产化率较低。根据数据，2022年，中国内资封装基板企业产值约5.71亿美元，仅占全球封装基板总产值的3.2%。

而且封装基板行业投资规模大、产能爬坡周期长，其中高端芯片封装基板制造所需的高解析、高精密度曝光机及配套ABF材料和设备的主要市场份额被日本企业占据，使得中国大陆封装基板企业在关键设备、原材料等方面长期依赖进口，行业景气度高时核心设备交付周期可达18-24个月，使得国内高端封装基板产能提升缓慢。同时，封装基板工厂的运营体系复杂，产能爬坡周期较长。根据近几年国产厂商封装基板项目情况来看，仅项目建设耗时就长达2年，后续还需数年时间用于产能爬坡，而且FC-

BGA等高端封装基板的项目设备价格昂贵，这就导致投资金额较高。

我国国产企业封装基板项目情况

公司

项目

产品

投资金额

达产所需时间

深南电路

广州封装基板生产基地

FC-BGA、FC-CSP及RF封装基板

60亿元

公告发布于2021年6月，一期项目已于2023年10月下旬连线，目前处于产线初步调试过程中。

高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目

FC封装基板

20.16亿元

公告发布于2022年2月，二期工厂已于2022年9月下旬连线投产，2023年12月产能利用率达到四成。

兴森科技

广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目

FCBGA封装基板

60亿元

公告发布于2022年2月，一期项目预计2025年达产，二期项目预计2027年12月达产。其中一期项目自获得用地至达产所需时间最长可达51个月，二期项目自完工至达产需30个月

胜宏科技

高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目

高端多层、高阶HDI印制线路板及封装基板

29.89亿元（其中封装基板项目的设备购置费高达8.02亿元）

建设期2年，预计第三年达产50%，预计第四年全部达产

和美精艺

珠海富山IC载板生产基地建设项目（一期）

存储芯片封装基板和FC-BGA封装基板

8亿元

建设期1年半后开始试运营

东山精密

设立全资子公司专业从事IC载板的研发、设计、生产和销售

封装基板

15亿元

-

中京电子

珠海集成电路(IC)封装基板产业项目

以生产FC-CSP、WB-CSP应用产品为主；开展FC-BGA应用产品的技术开发
15亿元

公告发布于2022年2月，截至2023年9月仍未盈利

资料来源：观研天下整理

4、我国封装基板行业相关专利也不断增长，市场规模持续扩大

因此，封装基板行业也成为国家重点支持和扶持的发展方向之一。近年来，我国封装基板行业相关专利不断增长，2021年专利申请量为584个，相比2015年增长了94.7%，国产化迫在眉睫。

整体从市场规模来看，在国家政策支持及相关企业积极突破技术桎梏下，我国封装基板行业市场规模不断扩大。根据数据显示，2021年中国封装基板市场规模为198亿元，预计2022年市场规模将达206亿元。

数据来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国封装基板行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国封装基板行业发展概述

第一节封装基板行业发展情况概述

一、封装基板行业相关定义

二、封装基板特点分析

三、封装基板行业基本情况介绍

四、封装基板行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、封装基板行业需求主体分析

第二节中国封装基板行业生命周期分析

一、封装基板行业生命周期理论概述

二、封装基板行业所属的生命周期分析

第三节封装基板行业经济指标分析

一、封装基板行业的赢利性分析

二、封装基板行业的经济周期分析

三、封装基板行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球封装基板行业市场发展现状分析

第一节全球封装基板行业发展历程回顾

第二节全球封装基板行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲封装基板行业地区市场分析

一、亚洲封装基板行业市场现状分析

二、亚洲封装基板行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲封装基板行业市场前景分析

第四节北美封装基板行业地区市场分析

一、北美封装基板行业市场现状分析

二、北美封装基板行业市场规模与市场需求分析

三、北美封装基板行业市场前景分析

第五节欧洲封装基板行业地区市场分析

一、欧洲封装基板行业市场现状分析

二、欧洲封装基板行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲封装基板行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界封装基板行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球封装基板行业市场规模预测

第三章 中国封装基板行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对封装基板行业的影响分析

第三节中国封装基板行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对封装基板行业的影响分析

第五节中国封装基板行业产业社会环境分析

第四章 中国封装基板行业运行情况

第一节中国封装基板行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国封装基板行业市场规模分析

一、影响中国封装基板行业市场规模的因素

二、中国封装基板行业市场规模

三、中国封装基板行业市场规模解析

第三节中国封装基板行业供应情况分析

一、中国封装基板行业供应规模

二、中国封装基板行业供应特点

第四节中国封装基板行业需求情况分析

一、中国封装基板行业需求规模

二、中国封装基板行业需求特点

第五节中国封装基板行业供需平衡分析

第五章 中国封装基板行业产业链和细分市场分析

第一节中国封装基板行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、封装基板行业产业链图解

第二节中国封装基板行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对封装基板行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对封装基板行业的影响分析

第三节我国封装基板行业细分市场分析

- 一、细分市场一
- 二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国封装基板行业市场竞争分析

第一节 中国封装基板行业竞争现状分析

- 一、中国封装基板行业竞争格局分析
- 二、中国封装基板行业主要品牌分析

第二节 中国封装基板行业集中度分析

- 一、中国封装基板行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国封装基板行业市场集中度分析

第三节 中国封装基板行业竞争特征分析

- 一、企业区域分布特征
- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国封装基板行业模型分析

第一节 中国封装基板行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节 中国封装基板行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国封装基板行业SWOT分析结论

第三节 中国封装基板行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国封装基板行业需求特点与动态分析

第一节中国封装基板行业市场动态情况

第二节中国封装基板行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节封装基板行业成本结构分析

第四节封装基板行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国封装基板行业价格现状分析

第六节中国封装基板行业平均价格走势预测

一、中国封装基板行业平均价格趋势分析

二、中国封装基板行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国封装基板行业所属行业运行数据监测

第一节中国封装基板行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国封装基板行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国封装基板行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国封装基板行业区域市场现状分析

第一节 中国封装基板行业区域市场规模分析

一、影响封装基板行业区域市场分布的因素

二、中国封装基板行业区域市场分布

第二节 中国华东地区封装基板行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区封装基板行业市场分析

(1) 华东地区封装基板行业市场规模

(2) 华南地区封装基板行业市场现状

(3) 华东地区封装基板行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区封装基板行业市场分析

(1) 华中地区封装基板行业市场规模

(2) 华中地区封装基板行业市场现状

(3) 华中地区封装基板行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区封装基板行业市场分析

(1) 华南地区封装基板行业市场规模

(2) 华南地区封装基板行业市场现状

(3) 华南地区封装基板行业市场规模预测

第五节 华北地区封装基板行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区封装基板行业市场分析

(1) 华北地区封装基板行业市场规模

(2) 华北地区封装基板行业市场现状

(3) 华北地区封装基板行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区封装基板行业市场分析

(1) 东北地区封装基板行业市场规模

(2) 东北地区封装基板行业市场现状

(3) 东北地区封装基板行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区封装基板行业市场分析

(1) 西南地区封装基板行业市场规模

(2) 西南地区封装基板行业市场现状

(3) 西南地区封装基板行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区封装基板行业市场分析

(1) 西北地区封装基板行业市场规模

(2) 西北地区封装基板行业市场现状

(3) 西北地区封装基板行业市场规模预测

第十一章 封装基板行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国封装基板行业发展前景分析与预测

第一节中国封装基板行业未来发展前景分析

一、封装基板行业国内投资环境分析

二、中国封装基板行业市场机会分析

三、中国封装基板行业投资增速预测

第二节中国封装基板行业未来发展趋势预测

第三节中国封装基板行业规模发展预测

一、中国封装基板行业市场规模预测

二、中国封装基板行业市场规模增速预测

三、中国封装基板行业产值规模预测

四、中国封装基板行业产值增速预测

五、中国封装基板行业供需情况预测

第四节中国封装基板行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国封装基板行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国封装基板行业进入壁垒分析

一、封装基板行业资金壁垒分析

二、封装基板行业技术壁垒分析

三、封装基板行业人才壁垒分析

四、封装基板行业品牌壁垒分析

五、封装基板行业其他壁垒分析

第二节封装基板行业风险分析

一、封装基板行业宏观环境风险

二、封装基板行业技术风险

三、封装基板行业竞争风险

四、封装基板行业其他风险

第三节中国封装基板行业存在的问题

第四节中国封装基板行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国封装基板行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国封装基板行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国封装基板行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节封装基板行业营销策略分析

一、封装基板行业产品策略

二、封装基板行业定价策略

三、封装基板行业渠道策略

四、封装基板行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/695341.html>